

江苏集萃集成电路应用技术创新中心实习研究生需求

一、 研究内容

主要研究内容为智能脑机交互系统研发，集成脑电、视觉、AI 算法等功能。

二、 工作职责

1. 负责相关产品的方案设计、论证、研发与升级；
2. 负责传感器、处理器等硬件的选型、设计与测试；
3. 负责产品的硬件焊接、调试和修正，配合软件工程师和测试分析部进行联调联试；
4. 负责产品相关设计文件、过程文件、测试文件的归档整理以及量产产品的版本控制；
5. 领导交办的其它事项。

三、 背景要求

1. 电子信息、计算机、物联网等相关专业；
2. 具备一定的模电、数电、无线通信等基础；（嵌入式方向）
3. 至少熟悉 AD、PADS、Cadence 等其中一种 EDA 工具；（嵌入式方向）
4. 至少熟悉 STM8、STM32、DSP 等其中一种 MCU 平台；（嵌入式方向）
5. 了解图像等人工智能算法、卡尔曼滤波等算法；（算法方向）
6. 熟悉万用表、示波器、逻辑分析仪等常规测试分析工具。（嵌入式方向）

四、 实习期限

3 个月以上，长期优先

五、 人数要求

嵌入式硬件: 1 人 嵌入式软件: 1 人 人工智能算法: 2 人

六、 实习地点

无锡市锡山区二泉东路 19 号集智商务广场（地铁 2 号线云林站附近）

七、 待遇

硕士实习生实习津贴 1500 元/月，外加按照实际出勤的交通午餐补贴 30/天

八、 联系方式

邮箱: qiyd@jitric.com

电话: 15886536111

江苏集萃集成电路应用技术创新中心简介

一、基本情况

江苏集萃集成电路应用技术创新中心（以下简称“创新中心”）由江苏省产业技术研究院（以下简称“江苏产研院”）、无锡市人民政府、锡山经济技术开发区共同建设，2020年8月5日签约落地，协议约定总投入9亿元，载体面积25000平方米，创新中心以制造业对集成电路的应用需求为出发点，着力解决制造业芯片需求的“卡脖子”难题。创新中心以“为江苏集成电路产业的技术创新提供支撑，为江苏集成电路产业的自立自强做出贡献”为使命，目标打造江苏省乃至长三角地区“应用牵引、资源整合”的自主可控工业芯片供应链平台。

二、功能定位

创新中心定位于“打造自主可控工业集成电路应用创新体系”。创新中心作为江苏产研院在集成电路领域统筹集成创新的总体牵头单位，统筹江苏产研院体系内集成电路应用创新相关的专业研究所、企业联合创新中心、项目经理及行业资源，通过构建产业技术创新体系、产业技术供给体系、研发产业生态体系，打通创新外部源头，理顺创新内在流程，营造最适于集成电路应用板块创新的生态环境。

三、组织架构

创新中心实行理事会领导下的中心主任负责制，理事会由江苏省科技厅、江苏省产业技术研究院、无锡市人民政府、无

锡市科技局、锡山区人民政府、锡山经开区代表及行业领域专家等共同组成。

四、发展战略

集萃芯 创新中心聚焦“工业控制、工业存储、工业传感、工业通信、工业器件”五大领域应用需求，打造“集萃芯”品牌；

VIDM 创新中心面向工业集成电路应用需求，聚集晶圆制造、元器件和 IP 模块工艺库、IC 设计、测试、应用解决方案、整机研发资源，以 VIDM 方式柔性整合，打造具有自主知识产权的稳定可靠供应链。

工业芯谷 创新中心通过空间、政策、金融等手段，集聚设计企业、产品公司、金融服务平台，形成多元化的开放创新生态环境，打造产业集聚的“工业芯谷”创新综合体。

五、服务能力

1. 芯片全流程设计
2. 敏捷设计云平台
3. 芯片测试验证
4. 供应链优化配置
5. 重大项目“揭榜挂帅”
6. “拨投结合”项目孵化培育

六、阶段成果

1. 揭榜挂帅项目：“呼吸机机用传感器国产化替代”联合攻关等项目

2. 拨投结合”项目：5G 基带芯片、VCSEL 激光器芯片等项目

七、业务合作

创新中心积极开展创新生态合作，与 IC 设计企业、晶圆制造企业、封测企业、龙头应用企业、EDA 工具商、材料设备商以及高校与科研院所等签署战略合作协议，在技术服务、项目科研、技术联合攻关、人才联合培养等方面展开多层次、全方位合作。